

**Mobile World Congress 2012, 27. Februar – 1. März
Halle 7, Stand 7G11**

Toshiba stellt neueste MIPI®-Lösung für hochauflösende Displays vor

Demos am Stand der MIPI Alliance zeigen zukünftige Display-Anwendungen auf der Basis der offenen MIPI-Spezifikation

Düsseldorf, 2. Februar 2012 – Toshiba Electronics Europe gibt bekannt, dass die Besucher des diesjährigen Mobile World Congress (MWC) in Barcelona erstmals Demos hochauflösender Display-Lösungen rund um das Mobile Industry Processor Interface (MIPI®) sehen werden.

Auf dem MWC wird unter anderem demonstriert, wie hochauflösende Displays mit mobilen Geräten verbunden werden – und zwar über Toshibas neuen Display Serial Interface (DSI)-zu-DisplayPort Bridge-IC TC358766XBG.

Erstmals werden auf dem MWC auch zukünftige Display-Anwendungen auf Basis der MIPI UniPro Highspeed-Interface-Architektur und dazugehörige UniPort-M Ports gezeigt. Display-Schnittstellen mit UniPort-M unterstützen große hochauflösende Displays und halten den Stromverbrauch minimal. Im Rahmen dieser Demos zeigt Toshiba, dass sich die UniPro-Schnittstelle für Anwendungen jenseits von Universal Flash Storage (UFS) und Kameras eignet.

Alle Demos finden am Stand der MIPI Alliance statt (Halle 7, Stand G11).

Die Mobile Industry Processor Interface (MIPI®) Alliance ist eine offene Organisation führender Anbieter im Bereich tragbarer Anwendungen. Sie hat sich zum Ziel gesetzt, offene Spezifikationen für Schnittstellen innerhalb tragbarer Geräte zu definieren und zu fördern.

DisplayPort ist eine digitale Display-Schnittstelle, die von der [Video Electronics Standards Association](#) (VESA) entwickelt wurde. Die Schnittstelle dient in erster Linie zum Anschluss einer Videoquelle an ein Display (z.B. ein Computer-Monitor), kann aber auch zur Übertragung von Audio-, USB- und anderer Daten verwendet werden.

UniProSM (Unified Protocol) ist eine Highspeed-Schnittstellentechnologie zur Verbindung von ICs in Mobiltelefonen oder vergleichbaren Produkten.

UFS ist eine fortschrittliche Spezifikation für Embedded- und austauschbare Flash-Speicherlösungen in tragbaren Geräten wie Smartphones und Tablets. Der UFS-Standard stellt eine Weiterentwicklung des JEDEC-Standards in diesem Bereich dar und wurde speziell für mobile Anwendungen und Rechner entwickelt, die eine hohe Leistungsfähigkeit und geringe Stromaufnahme bieten sollen. Der anfängliche Datendurchsatz mit UFS wird 300 Mbyte/s betragen. Der Standard unterstützt auch Command-Queuing-Funktionen, um die Random-Read/Write-Geschwindigkeiten zu erhöhen.

###

Zu Toshiba

Toshiba Electronics Europe (TEE) ist die europäische Niederlassung der Toshiba Corporation, einem der weltweit größten Halbleiterhersteller, die das Geschäft mit elektronischen Bauelementen verantwortet. TEE bietet eine der branchenweit umfangreichsten Produktlinien im Bereich ICs und diskrete Bauelemente, einschließlich Speicher, Mikrocontroller, ASICs, ASSPs und Displays für die Märkte Automotive, Multimedia, Industrie, Telekommunikation und Netzwerktechnik. Das Unternehmen bietet darüber hinaus auch eine Vielzahl von Leistungshalbleitern. TEE wurde 1973 in Neuss gegründet und stellt heute Design-, Fertigungs-, Marketing- und Vertriebsaktivitäten über seine Zentrale in Düsseldorf zur Verfügung. Weitere Niederlassungen finden sich in England, Frankreich, Italien, Schweden und Spanien. TEE beschäftigt in Europa ca. 300 Mitarbeiter. Präsident des Unternehmens ist Mr. Takashi Nagasawa.

Die Toshiba Corporation zählt zu den weltweit führenden Anbietern von Hochtechnologie und Fertigungsdienstleistungen rund um fortschrittliche Elektronik und Elektrotechnik. Dabei werden die Märkte digitale Unterhaltungselektronik; Elektronikgeräte und Elektronikbauteile; Stromversorgungssysteme, einschließlich Atomenergie; industrielle und soziale Infrastrukturnetzwerke sowie Haushaltsgeräte bedient. Toshiba wurde 1875 gegründet, betreibt heute ein weltweites Netzwerk mit über 490 Unternehmen und zählt an die 203.000 Mitarbeiter. Der Jahresumsatz des Unternehmens beträgt über \$77 Mrd. US-\$.

Weitere Informationen über Toshiba Electronics Europe unter: www.toshiba-components.com

Ansprechpartner für Veröffentlichungen:

Toshiba Electronics Europe, Hansaallee 181, D-40549 Düsseldorf, Deutschland

Tel: +49 (0) 211 5296 0 Fax: +49 (0) 211 5296 79 197

Web: <http://www.toshiba-components.com/pressoffice/index.asp>

E-mail: ASIC/SOC: customsoc-internet@toshiba-components.com

Ansprechpartner für die Presse:

Henning Rausch, Toshiba Electronics Europe

Tel: +49 (211) 5296 117

E-mail: HRausch@tee.toshiba.de

Herausgegeben durch:

Simon Flatt oder Andrew Town, Pinnacle Marketing Communications Ltd.

Telefon: +44 (0) 20 8869 9229/+44 (0) 20 8429 6546 Fax: +44 (0) 20 8868 4373

E-Mail: simon@pinnaclemarcom.com oder andrew@pinnaclemarcom.com

eb: www.pinnacle-marketing.com

Februar 2012

Ref. 6181/A